



**Government
eProcurement
System**

eProcurement System Government of India

Published Corrigendum Details

Date : 12-Mar-2025 10:43 AM

Print

Organisation Chain :	Indian Institute of Technology Ropar
Tender ID :	2025_IITRP_843875_2
Tender Ref No :	1998-24
Tender Title :	Tender for Supply and Installation of Wire Bonder
Corrigendum Type :	Retender

Corrigendum Document Details

Corr.No.	Corrigendum Title	Corrigendum Description	Corrigendum Reason	Published Date	Document Name	Doc Size(in KB)
1	RE TENDER CORRIGENDUM	RE TENDER CORRIGENDUM	Minimum Bids Not Received	12-Mar-2025 10:43 AM	CORRRETENDER1998.pdf	355.93



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROPAR

रूपनगर, पंजाब-140001/ Rupnagar, Punjab-140001
Ph. 01881-231285, 231283, e-mail: purchase@iitrpr.ac.in

संख्या. 1998-24/PH-10021/INSTT/PS/

12.03.2025

शुद्धिपत्र

CORRIGENDUM

संदर्भ निविदा सूचना संख्या 1998-24/PH-10021/INSTT/PS/ और CPPP निविदा आईडी संख्या 2025_IITRP_843875_2 **Tender for Supply and Installation of Wire Bonder** हेतु निविदा। निविदा निम्नानुसार पुनः निविदा की गई है:

Reference Tender Notice No. 1998-24/PH-10021/INSTT/PS/ and CPPP tender id number 2025_IITRP_843875_2 for **Tender for Supply and Installation of Wire Bonder**. The tender has been re-tendered as follows:

बोली अपलोड करने की अंतिम तिथि और समय Last Date and Time for Uploading of Bids	19.03.2025 (15:00 Hrs)
तकनीकी बोली खोलने की तिथि और समय Date and Time of Opening of Technical Bids	19.03.2025 (15:30 Hrs)

अन्य विवरण और नियम और शर्तें भी अपरिवर्तित रहेंगी।

The other details and terms & conditions also remain unchanged.

(Registrar)